



2026 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社フジインコーポレーテッド
代表者名 代表取締役会長 関 敬 史
(コード番号 5384 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 財務本部長 川 島 敏 裕
(TEL 052-503-8181)

「中長期経営計画 2026」策定に関するお知らせ

当社は 2023 年 5 月に「中長期経営計画 2023 (2024 年 3 月期～2029 年 3 月期)」(以下、「前中長計」)を公表いたしました。昨今の半導体市場の成長加速をはじめとする経営環境の変化に鑑み、今年度 2027 年 3 月期を初年度とする 6 ヶ年経営計画「中長期経営計画 2026(2027 年 3 月期～2032 年 3 月期)」(以下「本計画」)の策定を進めております。

今般、その定量面がまとまりましたので下記の通りお知らせいたします。なお、本計画の定性面も合わせた詳細に関しましては本年 11 月に公表いたします。

記

1. 基本方針・重要施策

当社は企業使命である「高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します」に基づき研磨材メーカーからパウダー&サーフェスカンパニーへの進化を遂げ、持続可能な社会の実現への貢献を目指しております。

本計画では、前中長計で策定した基本方針に変更はありませんが、重要施策は昨今の経営環境の変化に伴い変更を予定しております。

2. 環境変化

前中長計では予見されなかった以下の環境変化が起こり、商内の前提が大きく変わりました。

① 一般経済環境

前中長計期間の前半 3 年間にあたる 2023 年 4 月から 2026 年 3 月においては、ロシア・

ウクライナ情勢の長期化に加え、中東情勢の悪化、米中対立の激化、台湾海峡を巡る緊張など、地政学的リスクが一層高まる状況が続きました。こうした地政学的リスクの高まりや各国の金融政策の方向性の違い等を背景に、為替市場では円安基調が長期化し、輸入物価の上昇を通じてエネルギーや原材料等の調達コストを押し上げるなど、企業活動に大きな影響を及ぼしました。また、物価上昇に加え、構造的な人手不足や賃金上昇が進み、人件費を含む各種コストの上昇への対応が、企業経営における重要な課題となりました。

さらに、米国における関税政策の強化や、中国による重要鉱物・レアアース等の輸出規制の強化など保護主義的な動きにより、企業においては、調達先の多様化や在庫水準の見直し、生産拠点の分散・再配置など、事業継続性と安定供給の確保を重視したサプライチェーンの再構築が進められております。

加えて、2023 年以降の生成 AI 技術の飛躍的な進展は、半導体をはじめとする関連市場の需要を拡大させるとともに、企業活動そのものにも大きな変革をもたらしております。生産性向上や人手不足への対応にとどまらず、新たな付加価値の創出や競争力の強化に向け、デジタル技術を活用した業務プロセスや事業モデルの変革が、企業にとって一層重要な経営課題となっております。

また、地球温暖化の進行に伴う気候変動への対応が世界的な課題となる中、自然災害の激甚化・頻発化による社会・経済活動への影響も一層深刻化しております。脱炭素社会の実現や循環型経済への移行に向け、各国・地域において環境関連規制の強化が進んでおり、環境保全や持続可能性を重視した企業経営への要請は年々高まっております。

② 半導体市場

半導体市場は、コロナ禍における特需の反動により一時的な市場縮小が見られたものの、2024 年以降は回復基調に転じ、生成 AI の急速な普及やデータセンター投資の拡大を背景として、大きく成長しております。

今後も、生成 AI のさらなる高度化・普及に加え、AI とロボティクスの融合、フィジカル AI が次の成長領域として注目を集める等、半導体の用途拡大と高性能化・大容量化が一層進むものと見込まれます。半導体は、デジタル社会を支えるインフラとしての重要性をさらに高めており、中長期的にも継続的な市場拡大が期待されております。

こうした市場環境のもと、足元では AI 向け先端ロジック半導体や高帯域幅メモリ (HBM) をはじめとする先端メモリの需要が拡大し、半導体デバイスメーカー各社による生産能力の増強や先端プロセスへの設備投資が活発化しております。

3. 定量目標

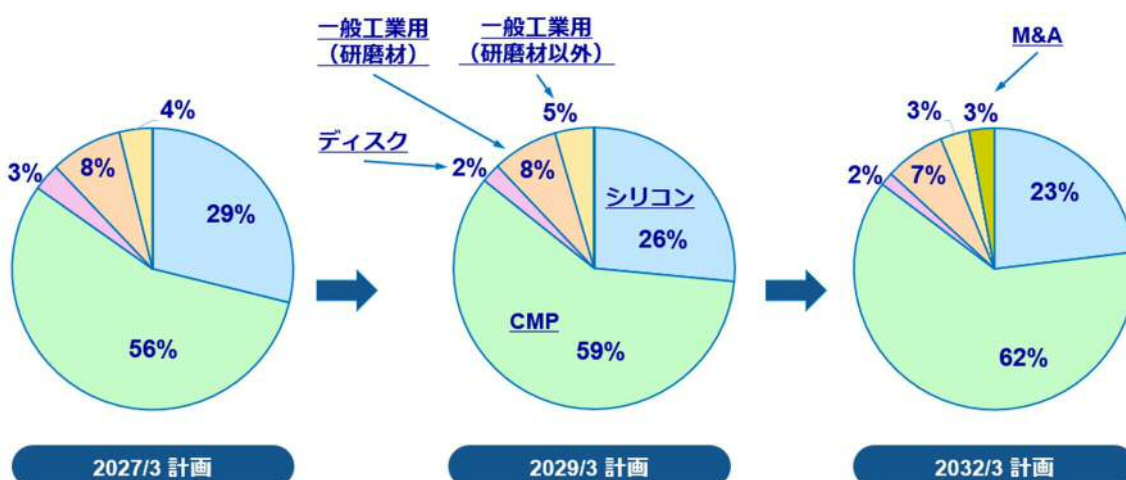
本計画における定量目標数値は以下の通りです。

目標項目	本計画1年目	本計画3年目	本計画6年目
	2027年3月期計画 (※)	2029年3月期計画	2032年3月期計画
売上高	825億円	1,040億円	1,380億円
営業利益率	20.9%	20%	21%
EBITDA マージン	26.0%	29%	31%
ROE	14.3%	14%	17%

(※) 詳細につきましては、本日発表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

用途別売上高

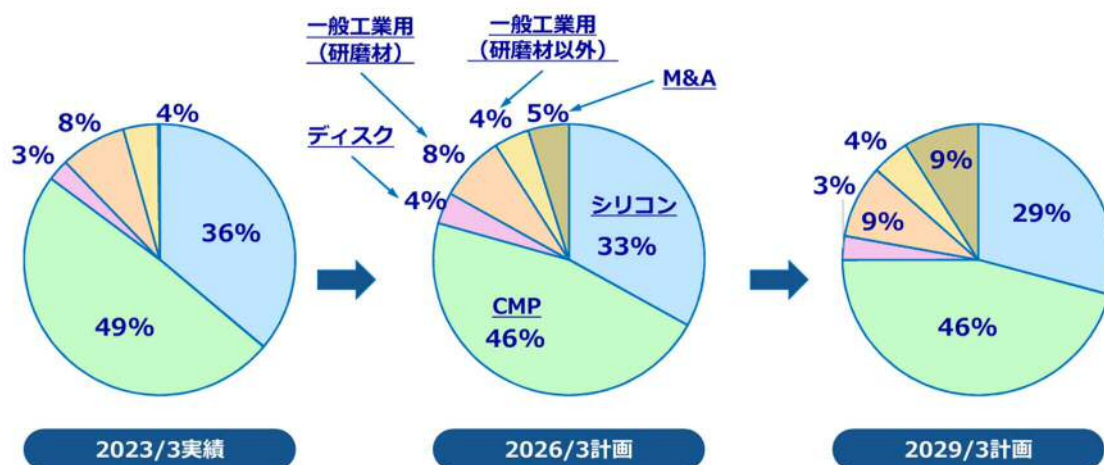
	本計画1年目	本計画3年目	本計画6年目
	2027年3月期計画	2029年3月期計画	2032年3月期計画
シリコン	238億円	276億円	318億円
CMP	461億円	615億円	858億円
ディスク	26億円	23億円	21億円
一般工業用 (研磨材)	68億円	79億円	96億円
一般工業用 (研磨材以外)	32億円	47億円	47億円
M&A	-	-	40億円



(参考) 中長期経営計画 2023 (前中長計)

目標項目	2023 年 3 月期実績	2026 年 3 月期計画	2029 年 3 月期計画
売上高	583 億円	770 億円	950 億円
営業利益率	22.7%	20%	20%
EBITDA マージン	25.6%	26%	27%
ROE	16.1%	15%	15%

用途別売上高



4. 投資計画

本計画における投資計画の概要は以下の通りです。

上述【2.環境変化】の通り、半導体市場の成長が続く中、半導体デバイスメーカーにおける当社製品への需要は一層の拡大が見込まれる一方、足元では当社の生産は高い稼働が続いております。今なお、拡大を続けるお客様の需要に確実に応えし、安定供給に対する責任を継続的に果たしていくためには、更なる生産能力の増強が不可欠であると考えております。

また、今後においても、半導体市場ではAIをはじめとする先端分野を中心に、市場拡大と技術の高度化が続くことが見込まれます。このような将来の成長機会を確実に取り込み、お客様の中長期的な事業拡大を支える供給体制を構築するためには、需要が顕在化してから対応するのではなく、将来を見据えて先行的かつ継続的に生産・研究開発基盤を整備していくことが極めて重要です。

したがって、本計画における設備投資は、単なる足元の需要増加への対応ではなく、将来に亘り安定供給責任を果たすとともに、当社の技術競争力を維持・強化し、中長期的な成長を実現していくために不可欠な戦略的投資と位置付けております。これらの投資を通じて、お客様に当社製品を長期に亘り安心してご採用・ご使用いただける研究開発体制ならびに供給体制を構築してまいります。

こうした考え方にに基づき、以下の投資を計画しております。

(1) 設備投資計画

- 本計画の6年間（2027年3月期～2032年3月期）累計で1,300億円の設備投資を計画
- 主な投資内容
 - ◇ 安定的な供給体制の拡充を目的とした生産能力増強投資（※）
 - ◆ 国内（岐阜県）：各務山工場（2026年2月竣工）の拡張
 - ◆ 各務山工場隣接地に新工場建設（工場用地取得済）
 - ◆ 台湾：新工場の建設（台湾子会社第2工場用地選定中）
 - （※ 最終投資決定には至っておりません）
 - ◇ 当社コア技術の強化、及び新技術開発に資する投資
 - ◆ 新研究所の建設（2026年末竣工予定）及び設備導入
 - ◆ 現開発拠点（海外拠点含む）における最先端の設備、機器の導入

(2) その他

- 新規事業創出等に向けた MA 投資

中長期経営計画 2026

	本計画 1 年目	本計画 3 年目	本計画 6 年目
	2027 年 3 月期計画	2029 年 3 月期計画	2032 年 3 月期計画
設備投資額	190 億円	850 億円 '27/3～29/3 3 カ年累計	450 億円 '30/3～32/3 3 カ年累計

(参考) 中長期経営計画 2023 (前中長計)

	2023 年 3 月期実績	2026 年 3 月期計画	2029 年 3 月期計画
設備投資額	21 億円	300 億円 '24/3～26/3 3 カ年累計	250 億円 '27/3～29/3 3 カ年累計

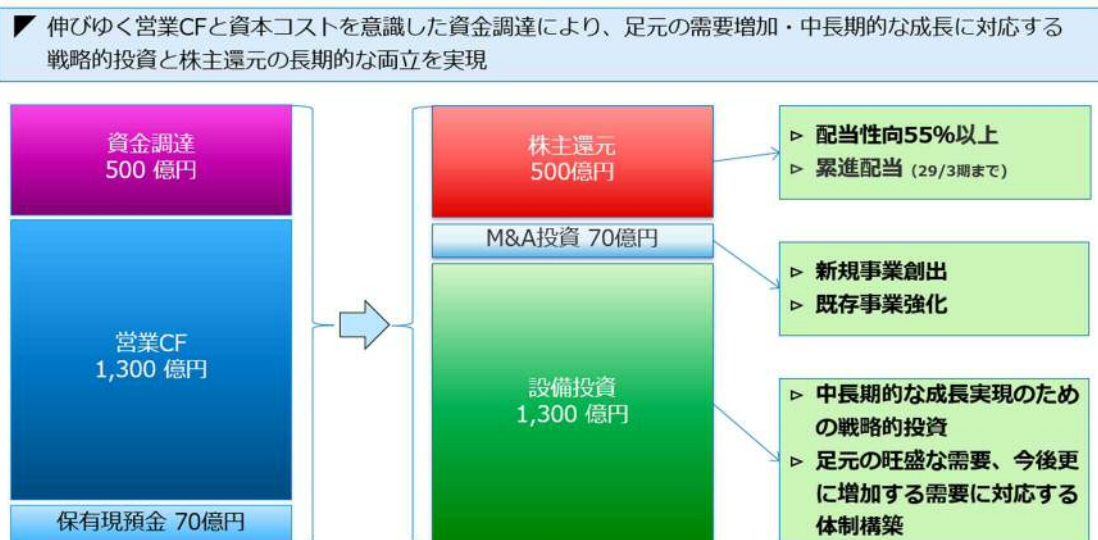
5. 株主還元

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、経営にあたっております。配当につきましては、業績に応じた積極的な株主還元と安定配当の継続を基本方針としており、具体的には、連結配当性向 55%以上を目標とし、前中長計期間である 2029 年 3 月期までは「配当維持または増配を行う累進配当」を適用しております（詳細は 2026 年 5 月 14 日付の「配当政策の変更に関するお知らせ」をご参照ください）。なお、2030 年 3 月期以降につきましては、今後も拡大が期待される半導体市場からの旺盛な需要に対する供給体制を整えるための更なる投資が必要になることから、投資による持続的成長と株主還元の長期的な両立を実現できるよう検討してまいります。

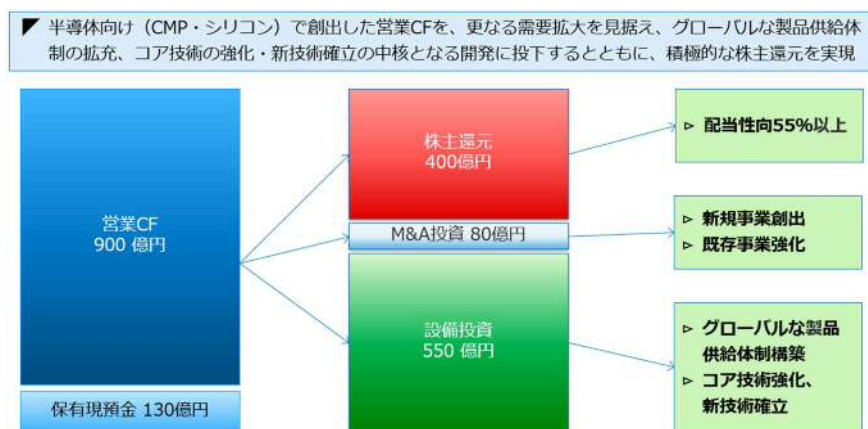
また、内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、お客様のニーズに応える開発・生産体制の強化、グローバルな事業戦略の遂行及び事業領域の拡大に役立てる所存であります。

6. キャッシュアロケーション

本計画におけるキャッシュアロケーションは以下の通りです。（6年間累計）



（参考）中長期経営計画 2023（前中長計：6 年間累計）



以上